

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ	5
1.1. Предмет материаловедения	5
1.2. История материаловедения	6
1.3. Проблемы и достижения материаловедения	13
Контрольные вопросы к главе 1	16
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ	17
2.1. Виды химической связи	17
2.2. Особенности строения твердых тел	24
2.3. Элементы зонной теории твердого тела	30
2.4. Основные свойства материалов	32
2.5. Параметры характеристик веществ в нанокристаллическом состоянии	38
2.5.1. Оптические характеристики	38
2.5.2. Магнитные свойства нанобъектов	49
2.5.3. Параметры характеристик механических свойств нанобъектов	54
Контрольные вопросы к главе 2	61
Глава 3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	62
3.1. Классификация материалов	62
3.2. Основы стандартизации материалов	68
3.3. Базы данных по материалам	70
3.4. Материаловедение XXI века – наноматериалы и нанотехнологии	75
Контрольные вопросы к главе 3	84
Глава 4. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	85
4.1. Железо и его сплавы	85
Контрольные вопросы к п. 4.1	101
4.2. Конструкционные стали и сплавы	101
4.2.1. Углеродистые конструкционные стали	107
4.2.2. Строительные низколегированные стали	109
4.2.3. Цементуемые легированные стали	110
4.2.4. Улучшаемые легированные стали	112

4.2.5. Высокопрочные стали	113
4.2.6. Пружинные стали.....	115
4.2.7. Износостойкие конструкционные стали.....	116
4.2.8. Коррозионно-стойкие стали и сплавы	117
4.2.9. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы	119
4.2.10. Литейные стали	128
Контрольные вопросы к п. 4.2	129
4.3. Инструментальные стали	130
4.3.1. Стали для режущего инструмента.....	130
4.3.2. Стали для измерительного инструмента	133
4.3.3. Стали для инструмента холодного деформирования.....	133
4.3.4. Стали для штампов горячего деформирования	134
Контрольные вопросы к п. 4.3	135
4.4. Чугуны.....	136
4.4.1. Структура чугуна	136
4.4.2. Серый и белый чугуны	139
4.4.3. Высокопрочный чугун.....	141
4.4.4. Ковкий чугун	142
4.4.5. Легированные чугуны.....	144
Контрольные вопросы к п. 4.4	145
4.5. Материалы, получаемые методами порошковой металлургии.....	146
4.5.1. Получение металлических порошков	146
4.5.2. Формование порошков	153
4.5.3. Спекание	157
4.5.4. Антифрикционные спеченные материалы	158
4.5.5. Фрикционные материалы	161
4.5.6. Пористые порошковые материалы.....	163
4.5.7. Электротехнические спеченные материалы.....	165
4.5.8. Конструкционные спеченные материалы.....	168
4.5.9. Тугоплавкие металлы и сплавы	173
4.5.10. Твердые сплавы	176
Контрольные вопросы к п. 4.5	177
4.6. Термическая обработка сталей	178
Контрольные вопросы к п. 4.6	185
4.7. Минералы и материалы на их основе	185
4.7.1. Твердые и сверхтвердые материалы	186
4.7.2. Минеральные материалы на основе силикатов	188
4.7.3. Стекло и ситаллы	191
4.7.4. Техническая керамика	200
4.7.5. Углеродсодержащие материалы	204
Контрольные вопросы к п. 4.7	207
4.8. Композиционные материалы	207
Контрольные вопросы к п. 4.8	219

4.9. Композиционные материалы на металлической матрице	220
4.9.1. Дисперсно-упрочненные материалы	221
4.9.2. Эвтектические композиты	224
4.9.3. Волокнистые композиционные материалы	227
Контрольные вопросы к п. 4.9	232
4.10. Композиты на керамической матрице	233
4.10.1. Компоненты и технология керамических композиционных материалов	233
4.10.2. Составы и применение керамических композиционных материалов	237
Контрольные вопросы к п. 4.10	239
4.11. Полимерные композиционные материалы	240
4.11.1. Классификация полимерных композитов	241
4.11.2. Наполненные пластики	243
4.11.3. Армированные композиты	249
4.11.4. Смесевые композиционные материалы	257
Контрольные вопросы к п. 4.11	262
4.12. Материалы на основе древесины	262
Контрольные вопросы к п. 4.12	275
4.13. Материалы для покрытий	276
4.13.1. Виды покрытий и способы их нанесения	276
4.13.2. Покрытия из лакокрасочных материалов	279
4.13.3. Покрытия из полимерных материалов и резин	284
4.13.4. Покрытия из металлов и сплавов	287
4.13.5. Неорганические неметаллические покрытия	289
Контрольные вопросы к п. 4.13	292

Глава 5. ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	293
5.1. Природа электропроводности металлов	293
5.1.1. Работа выхода	297
5.1.2. Термоэлектрические явления	298
5.1.3. Сверхпроводимость	303
5.1.4. Особенности свойств металлов в тонких слоях	309
Контрольные вопросы к п. 5.1	311
5.2. Материалы высокой проводимости	312
5.2.1. Классификация проводников	312
5.2.2. Медь	313
5.2.3. Алюминий	315
5.2.4. Золото	316
5.2.5. Серебро	317
5.2.6. Хром	318
5.2.7. Молибден	318
5.2.8. Платина	319
5.2.9. Палладий	320

5.2.10. Сплавы на основе меди и алюминия	320
5.2.11. Сверхпроводящие материалы	322
Контрольные вопросы к п. 5.2	326
5.3. Материалы высокого удельного сопротивления	326
5.3.1. Материалы для резисторов	327
5.3.2. Материалы для электронагревателей	331
5.3.3. Материалы для термопар	333
5.3.4. Припои и флюсы	335
Контрольные вопросы к п. 5.3	336
Глава 6. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	337
6.1. Механизмы проводимости	337
6.2. Поляризация	342
6.3. Диэлектрические потери	350
6.4. Классификация диэлектрических материалов	354
6.5. Органические диэлектрические материалы	354
Контрольные вопросы к главе 6	374
Глава 7. АКТИВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	375
7.1. Пьезоэлектрики	375
7.2. Пирозэлектрики	377
7.3. Сегнетоэлектрики	379
7.4. Электреты	381
7.5. Жидкие кристаллы	388
Контрольные вопросы к главе 7	391
Глава 8. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ	392
8.1. Зонная структура	392
8.2. Собственная и примесная проводимость	393
8.3. Контактные явления	400
8.4. Поглощение света полупроводниками. Фотопроводимость	404
Контрольные вопросы к главе 8	408
Глава 9. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	409
9.1. Классификация полупроводниковых материалов	409
9.2. Простые полупроводники	411
9.2.1. Кремний	411
9.2.2. Германий	413
9.3. Технология полупроводниковых монокристаллов	415
9.3.1. Направленная кристаллизация	415
9.3.2. Метод зонной плавки	416
9.3.3. Метод Чохральского	418
9.3.4. Метод вертикальной направленной кристаллизации	420
9.3.5. Метод горизонтальной направленной кристаллизации	422

9.4. Легирование полупроводников	422
Контрольные вопросы к главе 9	425
Глава 10. БИНАРНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	426
10.1. Полупроводниковые соединения $A^{III}B^V$	427
10.1.1. Структура соединений группы $A^{III}B^V$	427
10.1.2. Арсенид галлия	430
10.1.3. Арсенид индия	434
10.1.4. Антимонид индия	434
10.1.5. Антимонид галлия	435
10.1.6. Нитрид бора	436
10.2. Полупроводниковые соединения $A^{II}B^{VI}$	438
10.2.1. Характеристики основных свойств	439
10.2.2. Основные виды соединений типа $A^{II}B^{VI}$	440
10.2.3. Применение полупроводников типа $A^{II}B^{VI}$	443
10.3. Полупроводниковые соединения группы $A^{IV}B^{IV}$	444
10.3.1. Свойства карбида кремния	444
10.3.2. Получение карбида кремния	446
10.3.3. Применение карбида кремния	446
Контрольные вопросы к главе 10	448
Глава 11. ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ	449
11.1. МДП-структуры	451
11.2. Гомо- и гетероструктуры	451
11.3. Пленочные и гибридные интегральные схемы: основные понятия	453
11.4. Материалы тонкопленочных гибридных интегральных схем	456
11.4.1. Материалы для контактов	456
11.4.2. Материалы подложки	458
11.4.3. Тонкопленочные резисторы	460
11.4.4. Тонкопленочные конденсаторы	461
11.5. Тонкие диэлектрические пленки	462
11.6. Толстопленочные интегральные микросхемы	463
11.6.1. Подложки толстопленочных интегральных микросхем	464
11.6.2. Толстопленочные проводниковые пленки	464
11.6.3. Толстопленочные резисторы	465
11.6.4. Диэлектрические элементы	465
11.6.5. Межслойная и защитная изоляция	466
Контрольные вопросы к главе 11	467

Глава 12. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	468
12.1. Терминология	468
12.2. Магнетики	470
12.2.1. Диамагнетизм	471
12.2.2. Парамагнетизм	471
12.2.3. Ферромагнетизм и ферримагнетизм	472
12.3. Точка Кюри.....	473
12.4. Процессы при намагничивании ферромагнетиков	474
12.5. Магнитные потери, магнитострикция.....	479
Контрольные вопросы к главе 12	481
Глава 13. КЛАССИФИКАЦИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	482
13.1. Магнитно-мягкие материалы	483
13.2. Магнитно-твердые материалы.....	487
13.3. Терромагнитные сплавы	489
13.4. Материалы для магнитной записи.....	490
13.5. Цилиндрические магнитные домены	492
13.6. Магнитные тонкие пленки	495
Контрольные вопросы к главе 13	497
Глава 14. ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ	498
Контрольные вопросы к главе 14	517
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	518
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	521
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ	522
Приложение 1. Основные параметры характеристик физических свойств некоторых чистых металлов	522
Приложение 2. Основные параметры характеристик физико-механических свойств стекол, ситаллов и керамики	523
Приложение 3. Физико-механические характеристики термопластов	524
Приложение 4. Характеристики некоторых синтетических клеев	526
Приложение 5. Параметры характеристик германия, кремния и селена гексагональной модификации	527
Приложение 6. Некоторые характеристики полупроводниковых соединений $A^{III}B^V$ (при $T = 300$ К)	527
Приложение 7. Основные характеристики важнейших магнитно-мягких материалов	528
Приложение 8. Магнитные характеристики технических магнетиков	529

